

2022-2028年中国CMP抛光行业分析与发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国CMP抛光行业分析与发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202203/278575.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

摩尔定律下，代工制程节点不断缩小，布线层数持续增加，CMP成为关键制程。1991年IBM公司首次成功地将CMP技术应用到动态随机存储器的生产以来，随着半导体工业踏着摩尔定律的节奏快速发展，芯片的特征尺寸持续缩小，已发展至5~7nm。CMP已成功用于集成电路中的半导体晶圆表面的平面化。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的CMP抛光工艺步骤。

随着特征尺寸的缩小，以及布线层数增长，对晶圆平坦化精度要求不断增高，普通的化学抛光和机械抛光难以满足在当前集成电路nm级的精度要求，特别是目前对于0.35um制程及以下的器件必须进行全局平坦化，CMP技术能够全局平坦化、去除表面缺陷、改善金属台阶覆盖及其相关可靠性，从而成为目前最有效的抛光工艺。

抛光工艺对比	抛光工艺特点
化学抛光	表面精度较高，损伤低，完整性好，不容易出现表面/亚表面损伤，但研磨速率较慢，材料去除效率较低，不能修正表面型面精度，研磨一致性比较差
机械抛光	研磨一致性好，表面平整度高，研磨效率高容易出现表面层/亚表面层损伤，表面粗糙度值比较低
CMP	吸收了化学抛光和机械抛光的优点，目前CMP工艺能够在保证材料去除效率，并获得全局平整落差<100A。（相当于10nm原子级别）超高平整度。

数据来源：公开资料整理

中企顾问网发布的《2022-2028年中国CMP抛光行业分析与发展趋势研究报告》共十四章。首先介绍了CMP抛光行业市场发展环境、CMP抛光整体运行态势等，接着分析了CMP抛光行业市场运行的现状，然后介绍了CMP抛光市场竞争格局。随后，报告对CMP抛光做了重点企业经营状况分析，最后分析了CMP抛光行业发展趋势与投资预测。您若想对CMP抛光产业有个系统的了解或者想投资CMP抛光行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 CMP抛光行业发展综述

1.1 CMP抛光行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业主要产品分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 CMP抛光行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 CMP抛光行业在国民经济中的地位

1.2.3 CMP抛光行业生命周期分析

(1) 行业生命周期理论基础

(2) CMP抛光行业生命周期

1.3 最近3-5年中国CMP抛光行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒 / 退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 CMP抛光行业运行环境分析

2.1 CMP抛光行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 CMP抛光行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 CMP抛光行业社会环境分析

2.3.1 CMP抛光产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 CMP抛光产业发展对社会发展的影响

2.4 CMP抛光行业技术环境分析

2.4.1 CMP抛光技术分析

2.4.2 CMP抛光技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国CMP抛光行业运行分析

3.1 我国CMP抛光行业发展状况分析

3.1.1 我国CMP抛光行业发展阶段

3.1.2 我国CMP抛光行业发展总体概况

3.1.3 我国CMP抛光行业发展特点分析

抛光垫决定了CMP工艺的基础抛光效果，并结合设备操作过程、硅片、抛光液等因素，共同影响CMP抛光结果和效率。一般从平均磨除率、平整度和均匀性、选择比和表面缺陷四个维度来评判抛光效果。其中，抛光垫的物理化学等性能在CMP工艺中发挥了重要的作用。CMP抛光效果评判标准显现抛光垫决定基础抛光性能

标准	解释说明
平均磨除率	在设定时间内磨除材料的厚度
平整度和均匀性	平整度是硅片某处CMP前后台阶高度之差占CMP之前台阶高度的百分比
选择比	对不同材料的抛光速率是影响硅片平整性和均匀性的重要因素
表面缺陷	CMP工艺造成的硅片表面缺陷包括擦伤或沟、凹陷、侵蚀、残留物和颗粒污染
设备过程变量	作用压力P、硅片和抛光垫之间的相对速度、抛光时间、抛光区域温度及分布
硅片	表面应力分布、图案密度、形状
抛光液	化学性质、成分、pH值；粘度、温度、供给速度；磨粒尺寸、分布、硬度、形状
抛光垫	材料、密度、物理化学性质；硬度、厚度、粗糙度；结构、表面形态、稳定性

数据来源：公开资料整理

3.2 2015-2019年CMP抛光行业发展现状

3.2.1 2015-2019年我国CMP抛光行业市场规模

3.2.2 2015-2019年我国CMP抛光行业发展分析

3.2.3 2015-2019年中国CMP抛光企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2015-2019年重点省市市场分析

3.4 CMP抛光细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2015-2019年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 CMP抛光产品/服务价格分析

3.5.1 2015-2019年CMP抛光价格走势

3.5.2 影响CMP抛光价格的关键因素分析

- (1) 成本
- (2) 供需情况
- (3) 关联产品
- (4) 其他

3.5.3 2022-2028年CMP抛光产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要CMP抛光企业价位及价格策略

第四章 我国CMP抛光所属行业整体运行指标分析

4.1 2015-2019年中国CMP抛光所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2015-2019年中国CMP抛光所属行业产销情况分析

4.2.1 我国CMP抛光所属行业工业总产值

4.2.2 我国CMP抛光所属行业工业销售产值

4.2.3 我国CMP抛光所属行业产销率

4.3 2015-2019年中国CMP抛光所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国CMP抛光行业供需形势分析

5.1 CMP抛光行业供给分析

5.1.1 2015-2019年CMP抛光行业供给分析

5.1.2 2022-2028年CMP抛光行业供给变化趋势

5.1.3 CMP抛光行业区域供给分析

5.2 2015-2019年我国CMP抛光行业需求情况

5.2.1 CMP抛光行业需求市场

5.2.2 CMP抛光行业客户结构

5.2.3 CMP抛光行业需求的地区差异

5.3 CMP抛光市场应用及需求预测

5.3.1 CMP抛光应用市场总体需求分析

(1) CMP抛光应用市场需求特征

(2) CMP抛光应用市场需求总规模

5.3.2 2022-2028年CMP抛光行业领域需求量预测

(1) 2022-2028年CMP抛光行业领域需求产品/服务功能预测

(2) 2022-2028年CMP抛光行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业CMP抛光产品/服务需求分析预测

第六章 CMP抛光行业产业结构分析

6.1 CMP抛光产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国CMP抛光行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国CMP抛光行业产业链分析

7.1 CMP抛光行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 CMP抛光上游行业分析

7.2.1 CMP抛光产品成本构成

7.2.2 2015-2019年上游行业发展现状

- 7.2.3 2022-2028年上游行业发展趋势
- 7.2.4 上游供给对CMP抛光行业的影响
- 7.3 CMP抛光下游行业分析
 - 7.3.1 CMP抛光下游行业分布
 - 7.3.2 2015-2019年下游行业发展现状
 - 7.3.3 2022-2028年下游行业发展趋势
 - 7.3.4 下游需求对CMP抛光行业的影响

第八章 我国CMP抛光行业渠道分析及策略

- 8.1 CMP抛光行业渠道分析
 - 8.1.1 渠道形式及对比
 - 8.1.2 各类渠道对CMP抛光行业的影响
 - 8.1.3 主要CMP抛光企业渠道策略研究
 - 8.1.4 各区域主要代理商情况
- 8.2 CMP抛光行业用户分析
 - 8.2.1 用户认知程度分析
 - 8.2.2 用户需求特点分析
 - 8.2.3 用户购买途径分析
- 8.3 CMP抛光行业营销策略分析
 - 8.3.1 中国CMP抛光营销概况
 - 8.3.2 CMP抛光营销策略探讨
 - 8.3.3 CMP抛光营销发展趋势

第九章 我国CMP抛光行业竞争形势及策略

- 9.1 行业总体市场竞争状况分析
 - 9.1.1 CMP抛光行业竞争结构分析
 - (1) 现有企业间竞争
 - (2) 潜在进入者分析
 - (3) 替代品威胁分析
 - (4) 供应商议价能力
 - (5) 客户议价能力
 - (6) 竞争结构特点总结

9.1.2 CMP抛光行业企业间竞争格局分析

9.1.3 CMP抛光行业集中度分析

9.1.4 CMP抛光行业SWOT分析

9.2 中国CMP抛光行业竞争格局综述

9.2.1 CMP抛光行业竞争概况

(1) 中国CMP抛光行业竞争格局

(2) CMP抛光行业未来竞争格局和特点

(3) CMP抛光市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国CMP抛光行业竞争力分析

(1) 我国CMP抛光行业竞争力剖析

(2) 我国CMP抛光企业市场竞争的优势

(3) 国内CMP抛光企业竞争能力提升途径

9.2.3 CMP抛光市场竞争策略分析

第十章 CMP抛光行业领先企业经营形势分析

10.1 A公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 B公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 C公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4 D公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 E公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

10.6 F公司

10.6.1 企业概况

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色

10.6.4 公司经营状况

10.6.5 公司发展规划

第十一章 2022-2028年CMP抛光行业投资前景

11.1 2022-2028年CMP抛光市场发展前景

11.1.1 2022-2028年CMP抛光市场发展潜力

11.1.2 2022-2028年CMP抛光市场发展前景展望

11.1.3 2022-2028年CMP抛光细分行业发展前景分析

11.2 2022-2028年CMP抛光市场发展趋势预测

11.2.1 2022-2028年CMP抛光行业发展趋势

11.2.2 2022-2028年CMP抛光市场规模预测

11.2.3 2022-2028年CMP抛光行业应用趋势预测

11.2.4 2022-2028年细分市场发展趋势预测

11.3 2022-2028年中国CMP抛光行业供需预测

11.3.1 2022-2028年中国CMP抛光行业供给预测

11.3.2 2022-2028年中国CMP抛光行业需求预测

11.3.3 2022-2028年中国CMP抛光供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2022-2028年CMP抛光行业投资机会与风险

12.1 CMP抛光行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2022-2028年CMP抛光行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2022-2028年CMP抛光行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 CMP抛光行业投资战略研究

13.1 CMP抛光行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

- 13.1.4 区域战略规划
- 13.1.5 产业战略规划
- 13.1.6 营销品牌战略
- 13.1.7 竞争战略规划
- 13.2 对我国CMP抛光品牌的战略思考
 - 13.2.1 CMP抛光品牌的重要性
 - 13.2.2 CMP抛光实施品牌战略的意义
 - 13.2.3 CMP抛光企业品牌的现状分析
 - 13.2.4 我国CMP抛光企业的品牌战略
 - 13.2.5 CMP抛光品牌战略管理的策略
- 13.3 CMP抛光经营策略分析
 - 13.3.1 CMP抛光市场细分策略
 - 13.3.2 CMP抛光市场创新策略
 - 13.3.3 品牌定位与品类规划
 - 13.3.4 CMP抛光新产品差异化战略
- 13.4 CMP抛光行业投资战略研究
 - 13.4.1 2019年CMP抛光行业投资战略
 - 13.4.2 2022-2028年CMP抛光行业投资战略
 - 13.4.3 2022-2028年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议（ ）

- 14.1 CMP抛光行业研究结论
- 14.2 CMP抛光行业投资价值评估
- 14.3 CMP抛光行业投资建议
 - 14.3.1 行业发展策略建议
 - 14.3.2 行业投资方向建议
 - 14.3.3 行业投资方式建议（ ）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202203/278575.html>